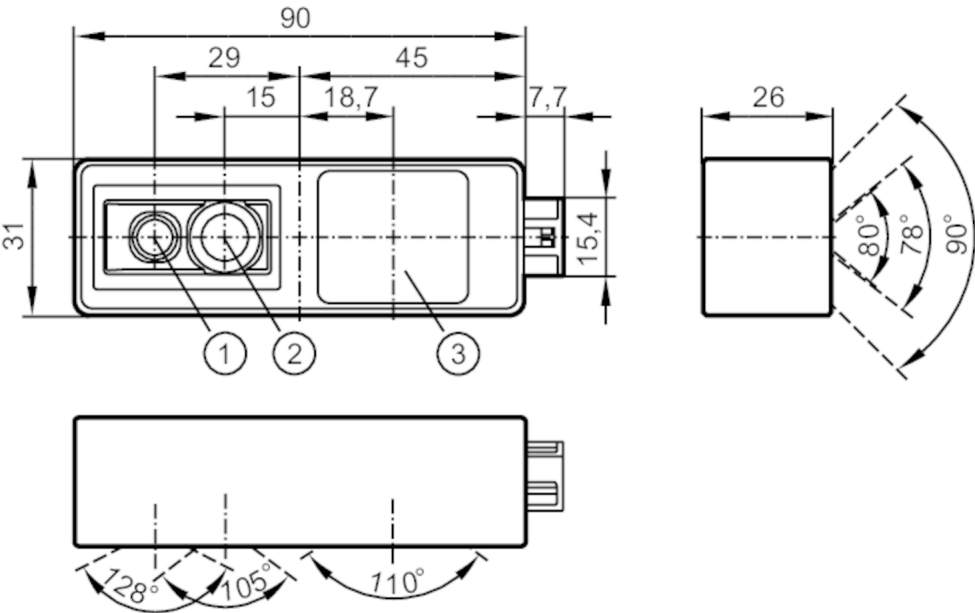


O3R225



3D成像系统

O3RI00KG/2D3D/ZN/O/W/105



- 1 2D摄像头
2 3D传感器
3 照明单位



产品特征		
图像分辨率	[px]	1280 x 800
图像分辨率3D	[px]	224 x 172
孔径角	[°]	128 x 80
孔径角3D	[°]	105 x 78
图像重复频率	[Hz]	20
图像重复频率3D	[Hz]	20
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流消耗最大值	[mA]	800
消耗功率	[W]	8.6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
图像传感器		PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
内部照明		有; (红外线: 940 nm 隐形辐射)
监控范围		
图像分辨率	[px]	1280 x 800
图像分辨率3D	[px]	224 x 172
孔径角	[°]	128 x 80
孔径角3D	[°]	105 x 78
图像重复频率	[Hz]	20
图像重复频率3D	[Hz]	20
接口		
传输标准		FPD-Link



3D成像系统

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

连接件型号		HFM (Mini-Fakra)	
工作条件			
环境温度		[°C]	-10...40
存储温度		[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 54	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN IEC 61000-64		干扰辐射 / 住宅、商业和轻工业环境
	EN IEC 61000-6-2		抗扰度 / 工业环境
抗冲击	EN 60068-2-27		50 g / (11 ms) 不重复
	EN 60068-2-27		40 g / (6 ms) 重复的
抗震	EN 60068-2-6		2 g / (10...150 Hz)
	EN 60068-2-64		2.3 g RMS / (10...500 Hz)
激光防护等级		1	
激光保护注意事项	注意：		激光
	激光等级：		1
			EN / IEC60825-1:2014
			符合21 CFR 1040，除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
电气安全		EN 61010-2-201	仅通过PELV电路供电
机械技术数据			
重量		[g]	170.9
尺寸		[mm]	90 x 31 x 26
原材料		外壳：模压铸锌 镀层；保护板：PMMA；窗口：玻璃 / PMMA；外壳后部：铝 镀层	
拧紧扭矩		[Nm]	< 0.8
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接插件：Dual-HFM			
其他数据			
像场大小			
距离 [m]		长度 [m]	宽度 [m]
1.00		2.60	1.70
2.00		5.20	3.35
3.00		7.80	5.05
4.00		10.40	6.70

O3R225



3D成像系统

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

单个像素的距离测量值可重复性

检测范围/距离 [m]	灰色物体距离测量值的重复精度(18%反射率) [mm]	精确度 [mm]
	标准值	标准值
0...1	± 7	± 9
1...2	± 15	± 10
2...3	± 30	± 12
3...4	± 51	± 13

图像中心的物体

环境温度20° C

反射率为18%到90%时的测量值

重复精度可使用滤波器功能优化

温度变化率

温度范围	-10...40 °C
温度变化率 [mm/K]	0.1